



平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成30年10月29日

上場会社名 東京エレクトロン デバイス株式会社 上場取引所 東
 コード番号 2760 URL <https://www.teldevice.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 徳重 敦之
 問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 田中 弘毅 (TEL) 045-443-4000
 四半期報告書提出予定日 平成30年11月8日 配当支払開始予定日 平成30年11月30日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成31年3月期第2四半期の連結業績(平成30年4月1日～平成30年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
31年3月期第2四半期	68,765	△10.0	1,701	69.0	1,390	41.4	894	27.8
30年3月期第2四半期	76,431	26.9	1,006	—	983	211.6	699	200.0

(注) 包括利益 31年3月期第2四半期 1,021百万円(68.8%) 30年3月期第2四半期 604百万円(—%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
31年3月期第2四半期	88.21	—
30年3月期第2四半期	69.31	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
31年3月期第2四半期	77,568	25,059	31.6
30年3月期	86,478	24,401	27.6

(参考) 自己資本 31年3月期第2四半期 24,489百万円 30年3月期 23,837百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
30年3月期	—	30.00	—	36.00	66.00
31年3月期	—	40.00	—	—	—
31年3月期(予想)	—	—	—	40.00	80.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 平成31年3月期の連結業績予想(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	140,000	△12.4	2,700	2.4	2,000	25.1	197.30

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注) 詳細は、添付資料 8 ページ「四半期連結財務諸表に関する注記事項」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

31年3月期2Q	10,445,500株	30年3月期	10,445,500株
----------	-------------	--------	-------------

② 期末自己株式数

31年3月期2Q	299,183株	30年3月期	322,655株
----------	----------	--------	----------

③ 期中平均株式数（四半期累計）

31年3月期2Q	10,136,852株	30年3月期2Q	10,091,572株
----------	-------------	----------	-------------

(注) 当社は、役員報酬BIP信託及び従業員持株ESOP信託を導入しており、各信託が所有する当社株式は自己株式に含めて記載しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項等については、添付資料 2 ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(セグメント情報)	9
(追加情報)	9
(重要な後発事象)	9
3. その他	10
(1) 仕入、受注及び販売の状況	10
(2) 経営計画 (VISION2020 成長に向けた変化への挑戦) について	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の拡大を背景に雇用・所得環境が改善する中、緩やかな回復が続いてまいりました。一方で、米中貿易摩擦の影響や中国経済の成長鈍化により、世界経済の下振れが懸念されるなど、先行きは不透明な状況となっております。

当社グループにおける当第2四半期連結累計期間の業績については、主要取引先との販売代理店契約解消の影響等により売上高は687億6千5百万円（前年同期比10.0%減）となったものの、平成29年7月に連結子会社となった株式会社アバル長崎の業績が期首より加わったことや、ストレージ関連機器の販売が好調に推移したことなどから、営業利益17億1百万円（前年同期比69.0%増）、経常利益13億9千万円（前年同期比41.4%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益8億9千4百万円（前年同期比27.8%増）となりました。

当社グループにおける報告セグメントに係る業績については、次のとおりであります。

(半導体及び電子デバイス事業)

平成29年11月1日に公表した主要取引先との販売代理店契約解消による取り扱い製品の減少等により、当第2四半期連結累計期間は売上高596億5千3百万円（前年同期比12.9%減）となったものの、相対的に利益率の高い製品の販売が産業機器・自動車関連向けに堅調な推移となったことなどから、セグメント利益（経常利益）は8億8千2百万円（前年同期比27.7%増）となりました。なお、株式取得によって平成30年7月から株式会社ファーストが連結子会社となっており、同社の業績等は半導体及び電子デバイス事業に含めております。

(コンピュータシステム関連事業)

データセンター市場においては、データ処理量の増加やIoT（モノのインターネット）の普及等により、これらに対応するための設備投資が増加傾向で推移しております。当社では金融機関、官公庁及びデータセンター事業者向けの製品販売が好調に推移し、当第2四半期連結累計期間は売上高91億1千1百万円（前年同期比14.4%増）、セグメント利益（経常利益）5億8百万円（前年同期比74.0%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末における総資産は775億6千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ89億1千万円の減少となりました。これは主に、売上債権が減少したことによります。負債総額は525億9百万円となり、前連結会計年度末に比べ95億6千8百万円の減少となりました。これは主に、短期借入金が減少したことによります。また、純資産は250億5千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億5千8百万円の増加となりました。以上の結果、自己資本比率は31.6%となり、前連結会計年度末に比べ4.0ポイント向上いたしました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成31年3月期の通期連結業績予想については、現在の事業環境や第3四半期以降におけるビジネス動向等を勘案し、次のとおり修正することといたしました。

	売上高	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり当期純利益
前回（平成30年4月24日） 発表予想（A）	百万円 140,000	百万円 2,700	百万円 1,800	円 銭 177.82
今回発表予想（B）	140,000	2,700	2,000	197.30
増 減 額（B－A）	0	0	200	—
増 減 率（％）	0.0	0.0	11.1	—
（参考）前期連結実績 （平成30年3月期）	159,841	2,637	1,598	158.22

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,606	3,872
受取手形及び売掛金	42,263	33,598
電子記録債権	1,566	1,888
商品及び製品	25,638	24,813
原材料	439	869
その他	6,912	4,536
貸倒引当金	-	△23
流動資産合計	80,427	69,554
固定資産		
有形固定資産	1,241	1,656
無形固定資産	258	2,050
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	410	428
その他	4,182	3,945
貸倒引当金	△41	△66
投資その他の資産合計	4,551	4,307
固定資産合計	6,051	8,014
資産合計	86,478	77,568

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	10,497	9,700
短期借入金	21,065	14,546
1年内返済予定の長期借入金	3,096	222
賞与引当金	1,237	1,004
その他	8,222	8,485
流動負債合計	44,117	33,959
固定負債		
長期借入金	10,096	10,210
退職給付に係る負債	7,371	7,744
その他	492	594
固定負債合計	17,959	18,549
負債合計	62,077	52,509
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,495	2,495
資本剰余金	5,645	5,645
利益剰余金	16,234	16,752
自己株式	△478	△443
株主資本合計	23,897	24,450
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	43	33
繰延ヘッジ損益	132	21
為替換算調整勘定	102	242
退職給付に係る調整累計額	△338	△258
その他の包括利益累計額合計	△59	39
非支配株主持分	563	570
純資産合計	24,401	25,059
負債純資産合計	86,478	77,568

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月 1日 至 平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月 1日 至 平成30年9月30日)
売上高	76,431	68,765
売上原価	68,151	59,381
売上総利益	8,279	9,383
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	2,874	3,039
賞与引当金繰入額	835	867
退職給付費用	373	475
その他	3,189	3,301
販売費及び一般管理費合計	7,273	7,682
営業利益	1,006	1,701
営業外収益		
保険配当金	41	41
その他	30	28
営業外収益合計	71	69
営業外費用		
支払利息	66	96
為替差損	-	252
その他	28	31
営業外費用合計	94	380
経常利益	983	1,390
特別利益		
固定資産売却益	-	0
負ののれん発生益	46	-
特別利益合計	46	0
特別損失		
固定資産売却損	-	0
固定資産除却損	6	1
投資有価証券評価損	-	20
特別損失合計	6	22
税金等調整前四半期純利益	1,023	1,368
法人税等	308	446
四半期純利益	715	922
非支配株主に帰属する四半期純利益	15	27
親会社株主に帰属する四半期純利益	699	894

四半期連結包括利益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月 1日 至 平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月 1日 至 平成30年9月30日)
四半期純利益	715	922
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△3	△10
繰延ヘッジ損益	△135	△110
為替換算調整勘定	16	146
退職給付に係る調整額	13	80
持分法適用会社に対する持分相当額	△0	△6
その他の包括利益合計	△110	99
四半期包括利益	604	1,021
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	589	993
非支配株主に係る四半期包括利益	15	27

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月 1日 至 平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月 1日 至 平成30年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	1,023	1,368
減価償却費	261	227
のれん償却額	-	8
負ののれん発生益	△46	-
賞与引当金の増減額 (△は減少)	98	△236
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	172	124
支払利息	66	96
為替差損益 (△は益)	147	893
投資有価証券評価損益 (△は益)	-	20
売上債権の増減額 (△は増加)	△2,489	9,595
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△3,131	1,016
仕入債務の増減額 (△は減少)	633	△1,177
未払金の増減額 (△は減少)	△89	△255
前受金の増減額 (△は減少)	909	978
未収消費税等の増減額 (△は増加)	57	1,105
未収入金の増減額 (△は増加)	76	945
前払費用の増減額 (△は増加)	△365	△254
その他	△197	△695
小計	△2,873	13,760
利息及び配当金の受取額	3	4
利息の支払額	△66	△98
法人税等の支払額	△536	△948
営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,473	12,718
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△50	△86
有形固定資産の売却による収入	-	174
無形固定資産の取得による支出	△90	△22
投資有価証券の取得による支出	△20	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△595	△1,833
その他	△2	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△759	△1,767
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	5,203	△7,169
長期借入金の返済による支出	△48	△3,235
自己株式の処分による収入	41	47
配当金の支払額	△302	△364
非支配株主への配当金の支払額	-	△21
その他	△0	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,894	△10,744
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	6
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	664	212
現金及び現金同等物の期首残高	2,433	3,406
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,097	3,619

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

該当事項はありません。

(参考)

当社の連結子会社でありましたパネトロン株式会社は、平成30年7月1日付で当社を存続会社とする吸収合併により消滅したため当第2四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。なお、特定子会社ではありません。

当第2四半期連結会計期間より、株式会社ファーストを新たに連結の範囲に含めております。なお、特定子会社ではありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

(セグメント情報)

I 前第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	68,468	7,963	76,431	—	76,431
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	68,468	7,963	76,431	—	76,431
セグメント利益	691	291	983	—	983

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

II 当第2四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	59,653	9,111	68,765	—	68,765
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	59,653	9,111	68,765	—	68,765
セグメント利益	882	508	1,390	—	1,390

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

(追加情報)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

(重要な後発事象)

(投資有価証券の売却)

当社は、平成30年10月9日の取締役会決議に基づき、当社が保有する投資有価証券の一部を売却いたしました。これに伴い、平成31年3月期第3四半期連結会計期間において投資有価証券売却益（特別利益）を計上する予定であります。

- | | |
|---------------|---------------|
| (1) 売却株式 | 当社保有の非上場株式1銘柄 |
| (2) 売却株式数 | 1,355,993株 |
| (3) 売却日 | 平成30年10月12日 |
| (4) 投資有価証券売却益 | 207百万円（予定） |

3. その他

(1) 仕入、受注及び販売の状況

① 仕入実績

当第2四半期連結累計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	仕入高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	52,412	△19.7
コンピュータシステム関連事業	6,232	3.2
合計	58,644	△17.8

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

当第2四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高 (百万円)	前年同四半期比 (%)	受注残高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	56,038	△29.3	24,674	△25.9
コンピュータシステム関連事業	9,308	8.2	10,079	15.8
合計	65,346	△25.6	34,754	△17.3

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

当第2四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	59,653	△12.9
コンピュータシステム関連事業	9,111	14.4
合計	68,765	△10.0

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 経営計画 (VISION2020 成長に向けた変化への挑戦) について

当社は中期経営計画 VISION2020 (2016年3月期～2021年3月期) において「売上高 2,000億～2,200億円」及び「ROE 10%」の達成を目標に掲げ、これまでの3年間 (2016年3月期～2018年3月期) を「成長に向けた事業インフラを整備する期間」、これからの3年間 (2019年3月期～2021年3月期) を「事業の成長を実現する期間」と位置付け、取り組んでまいりました。

VISION2020の達成に向けた後半3年間のスタートにあたり、現時点における計画の見通しについてお知らせいたします。

今回、中期経営計画の指標として経常利益率を新たに加え、ROEの見通しは当初から5ポイント引き上げて15%といたしました。

	当初の目標値	現時点の見通し
売上高	2,000～2,200億円	2,000億円
経常利益率	—	3.5%以上
ROE	10%	15%

また、各事業の「売上構成比 (経常利益率)」のイメージにつきましても次のとおり変更いたしました。

	当初の想定	現時点の想定
EC事業	60% (2%)	80% (2%)
PB事業	20% (10%)	8% (10%)
CN事業	20% (10%)	12% (10%)

売上構成比につきましてはEC事業における売上規模の拡大を勘案し、当初想定から引き上げ、これに対しPB事業及びCN事業は事業状況を鑑み、当初想定から引き下げております。なお、各事業の経常利益率につきましては、当初の想定から変更していません。

当社は VISION2020 の更にその先も見据え、収益性の高い事業へ引き続き注力することにより、企業価値の向上に取り組んでまいります。

※「EC事業」は半導体及び電子デバイス事業を、「PB事業」は自社ブランド事業を、「CN事業」はコンピュータシステム関連事業をそれぞれ示しております。なお、現在のセグメント区分上、PB事業は半導体及び電子デバイス事業に含まれております。